

2008年微电子封装材料行业发展 预测与市场研究报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2008年微电子封装材料行业发展预测与市场研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/Z127198WVV.html>

报告价格：纸质版：8000元 电子版：8600元

智研数据研究中心

订购电话： 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真： 010-60343813

Email： sales@abaogao.com

联系人： 刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

2008年微电子封装材料行业发展预测与市场研究报告 内容介绍：

第一章 微电子封装材料行业发展环境分析

第一节 全球IC封装产业的发展

- 一、世界IC封装产品市场的发展
- 二、全球各类封装形式的发展变化
- 三、全球主要IC封装测试厂商
- 四、全球IC封装产业发展趋势

第二节 中国IC封装产业发展分析

- 一、中国IC封测业发展概述
- 二、我国IC封测业现状
- 三、国内IC封测行业发展分析

第一节 引线框架的产品概述

第二节 引线框架的性能要求

第三节 引线框架的发展

第四节 世界及我国的引线框架行业的现状

- 一、世界引线框架市场规模预测
- 二、国内键合丝发展中存在的问题及行业发展趋势
- 一、中国键合金丝产业发展中存在的问题
- 二、中国键合金丝行业发展分析

第一节 环氧塑封料的产品概述

第二节 环氧塑封料的组成成分

- 一、环氧树脂
- 二、固化剂
- 三、硅微粉填料
- 四、固化促进剂
- 五、偶联剂

第三节 环氧塑封料性能

- 一、未固化物理性能
- 二、固化后物理性能

四、热性能

五、导热机械性能

六、机械性能

七、化学性能

八、阻燃性能

九、贮存性能

十、封装性能

第四节 世界环氧塑封料产业现状与发展

一、世界环氧塑封料业的发展现状

二、海外环氧塑封料行业状况及主要厂商

第五节 我国环氧塑封料产业现状与发展

一、我国环氧塑封料产业现状概述

二、我国环氧塑封料的市场需求情况

三、我国环氧塑封料的技术现状

四、我国环氧塑封料的主要生产厂家

五、中国塑封料发展

一、总述

二、我国国内主要生产锡球的厂家

第六节 无铅化锡球的发展

一、锡球实现无铅化的背景

二、无铅焊料产品与应用

三、我国在无铅焊料方面的工作开展

第七章 环氧导电（热）胶发展分析

第一节 环氧导电（热）胶现状

第二节 环氧导电（热）胶市场需求及主要制造厂商

第三节 我国与国外相比存在的差距及研究方向

第八章 封装基板发展分析

第一节 封装基板的产品概述

一、封装基板

二、按照不同组成基材的分类

第二节 世界IC封装基板生产现状与发展

一、世界IC封装基板发展历程及特点分析

二、世界IC封装基板生产与市场总况

三、世界IC封装基板主要生产国家、地区

四、世界IC封装基板生产品种情况

五、IC封装基板售价变化情况

第三节 世界IC封装基板主要生产厂家

一、世界IC封装基板主要大型生产厂家概述

二、世界IC封装基板主要生产厂家情况

第四节 我国IC封装基板业的现状与发展

一、我国IC封装基板生产现状与特点

二、我国IC封装基板主要生产企业

第九章 液体环氧封装料

第一节 液体环氧封装料概述及分类

第二节 液体环氧封装料市场情况

第十章 封装厂家竞争力研究

第一节 飞思达半导体（中国）有限公司

第二节 奇梦科技（苏州）有限公司

第三节 威讯联合半导体（北京）有限公司

第四节 江苏新潮科技集团有限公司

第五节 上海松下半导体有限公司

第六节 深圳赛意法半导体有限公司

第七节 南通华达微电子集团有限公司

.....

第十一章 微电子封装用材料行业发展建议及市场前景分析

第一节 微电子封装材料行业发展建议

第二节 微电子封装材料市场前景分析

部分图表目录

图表、全球各国（地区）IC市场占有率

图表、世界IC载板市场规模与历年增长率（单位：百万美元）

图表、2007年全球IC载板产品类别

图表、世界主要有机IC封装基板的大型生产厂家

图表、世界IC封装基板发展预测

图表、世界不同封装形式的IC封装基板时常的统计及预测

图表、国内封装测试企业地域分布情况

图表、国内上市三家IC封装测试企业情况

图表、2007年国内IC封测企业前30家销售收入表

图表、中国主要封装企业一览表

图表、2007年中国IC封装测试业前十大企业销售额

图表、通富微电公司主营业务、净利润及毛利率情况

图表、通富微电公司2007年产品主要销售分布区域

图表、2007年世界货物贸易进出口额前十名 金额单位：10亿美元

图表、2006-2008年世界经济和世界贸易增长趋势 单位：%

图表、SOP封装产品

图表、几种类型CSP结构组成图

图表、封装了8个芯片的MCP技术结构图

图表、IC封装有着许多种尺寸、形状和引脚数量，以满足IC和系统不同的要求

图表、不同寻常的BGA封装结构的示意图

图表、先进的封装技术发展趋势

图表、引线框架的产品

图表、铜基引线框架材料的分类

图表、插入型集成电路

图表、表面实装型集成电路

图表、三种引线键合工艺

图表、引线键合的两种引线键合形式

图表、球形焊接和楔形焊接技术参数

图表、键合金丝化学成份

图表、键合金丝机械性能

图表、键合金丝产品分类

图表、高性能铝硅市场规模与历年增长率（单位：百万美元）

图表、2007年全球IC载板产品类别

图表、世界主要有机IC封装基板的大型生产厂家

图表、典型的封装结构

图表、各种封装结构外形

图表、世界半导体封装材料各国家、地区市场规模的统计

图表、各类封装形式在封装总量中所占的份额

图表、引线框架在封装中的应用举例
图表、世界半导体引线框架市场规模及预测
图表、中国引线框架市场规模统计及预测
图表、2002-2009年国内键合金丝市场规模 单位：新台币亿元
图表、电子安装的不同等级与采用PCB 的关系
图表、2004-2008年台湾PCB市场规模分析
图表、世界液体环氧封装料市场需求及预测
图表、半导体封装的功能
图表、三种引线键合方法特征对比
图表、金丝成分分析
图表、各种键合丝特征对比
图表、环氧塑封料组成配方
图表、不同类型填料的主要性能比较
图表、各种固化促进剂的主要性能比较
图表、按照不同的熔点划分的锡球种类
图表、焊锡球的产品规格
图表、BGA封装用焊球
图表、IC封装基板品种的不同分类
略.....

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/Z127198WVV.html>